



聯系:

投資人關係

+86-21-3861-0000*12804

ir@smics.com

中國上海 — 2012年5月10日 — 國 主要半導體代工製造商中芯國 集成電路製造有限公司(紐約交易所: SMI; 香港聯交所: 981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

**所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。
報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。**

二零一二年第一 摘要

- 二零一二年第一季的總銷售額由二零一一年第四季的貳億捌仟萬陸拾萬元上升14.9%至三億三仟貳佰柒拾萬元，與二零一一年第一季相比下降10.2%。
- 二零一二年第一季的毛利率由二零一一年第四季的-7.4%上升至12.0%主要是由於更高的產能利用率及於二零一二年第一季採取的成本擰節舉措所致。
- 二零一二年第一季來自於經營活動的現金淨額由二零一一年第四季的捌仟肆佰柒拾萬元減少至三仟伍佰捌拾萬元，主要是由於二零一一年第四季認列增值稅返還。
- 二零一二年第一季普通股持有人應佔虧損為肆仟貳佰捌拾萬元，相對二零一一年第四季應佔虧損為壹億陸仟伍佰貳拾萬元。
- 每股美國預托股股份虧損為(0.08)元。

二零一二年第二 指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 收入預期上升19%至21%。
- 毛利率預期在19%至22%範圍內。
- 預期經營開支去除匯兌損益介乎於1億零1百萬至1億零4百萬元之間。

首席執行官邱慈雲博士表示：「二零一二年第一季度的營收相對二零一一年第四季增長了 15%，而我們第二季度的營收增長預期將介乎 19%至 21%之間。展望二零一二年下半年，我們的目標是持 增長。此持 增長的動力主要來自通訊晶片、移動電話及機頂盒的多種新產品的加速生產；以及現有產品需求的增長。除了 觀因素，我們整體表現的改善也是推動產品需求和產能利用率增長的動力來源。」

「我們於中國區的營收隨著中國的半導體市場的成長持 增長。在二零一二年第一季度，來自中國區的晶圓收入比二零一一年第四季度增長 9.5%，約佔本公司二零一二年第一季度晶圓收入的 32.5%。」

「在二零一二年第一季度，我們成功獲得兩項主要銀團貸款。首先，在二月我們取得了 2 億 6 千 8 百萬美元的貸款額度，其次，在三月取得一項 6 億美元的銀團貸款。這些授信安排將 助我們達到更爲健康的資本結構，也顯示政策性銀行及商業銀行對我們發展潛力的認可。」

「我們對接下來的季度增長前景感到鼓舞，其持 訂單勢頭來自於國 及中國的主要客戶，包括了應用於多種領域的現有產品及新產品。」

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一二年五月十一日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-866-519-4004(密碼：SMIC)，中國 40-0620-8038(密碼：SMIC)，香港 852-2475-0994(密碼：SMIC)或臺灣 886-2-2650-7825(密碼：SMIC)

二零一二年第一季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

<http://www.media-server.czom/m/p/mmjw93d2>

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最 大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一二年第二季指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重 已 及未 風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實 業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重 差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及 材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一二年四月二十七日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未 或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重 不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他 因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

中芯國 已向美國證券交易所以 20-F 格式呈交 2011 年年報。該年報刊登於公司網站 www.smics.com。此外，所有公司美國預托股股份持有者可免費申請取得紙張印本年報一本。

二零一二年第一 經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一二年 第一季度	二零一一年 第四季度	季度比較	二零一一年 第一季度	年度比較
銷售收入	332,711	289,628	14.9%	370,559	-10.2%
銷售成本	292,867	310,959	-5.8%	301,782	-3.0%
毛利(損)	39,844	(21,331)	-	68,777	-42.1%
經營開支	90,128	85,667	5.2%	76,623	17.6%
經營虧損	(50,284)	(106,998)	-53.0%	(7,846)	540.9%
其他收入(支出), 淨額	(4,069)	5,430	-	2,702	-
所得稅利益(費用)	11,418	(65,040)	-	128	8820.3%
稅後淨虧損	(42,935)	(166,608)	-74.2%	(5,016)	756.0%
應佔股權投資盈利	373	1,784	-79.1%	1,016	-63.3%
停止經營產生之稅後淨盈利 ⁽¹⁾	-	-	-	14,742	-
淨盈利(虧損)	(42,562)	(164,824)	-74.2%	10,742	-
非控制權益持有人利息	(263)	(381)	-31.0%	(508)	-48.2%
普通股持有人應佔盈利(虧損)	(42,825)	(165,205)	-74.1%	10,234	-
毛利率	12.0%	-7.4%	-	18.6%	-
經營利潤率	-15.1%	-36.9%	-	-2.1%	-
每股普通股股份虧損-基本和攤薄 ⁽²⁾	(0.00)	(0.01)	-	0.00	-
每股美國預托股份虧損-基本和攤薄	(0.08)	(0.30)	-	0.02	-
付運晶圓(約當 8 吋) ⁽³⁾	445,689	374,116	19.1%	471,231	-5.3%
產能使用率 ⁽⁴⁾	74.1%	65.6%	8.5%	76.3%	-2.2%

附注：

- (1) 於二零一一年三月一日，公司出售其於 AT 的主要擁有權益，持股比例下降至 10%，而不再將該公司合入帳。AT 由二零一一年一月一日止不再綜合入帳期間的營運業績及取消 AT 綜合入帳的收益均歸在終止業務收入項下。
- (2) 基於二零一二年第一季加權平均普通股 275 億 400 萬股(基本)及 275 億 400 萬股(攤薄)，二零一一年第四季 274 億 8 千 300 萬股(基本)及 274 億 8 千 300 萬股(攤薄)，二零一一年第一季 273 億 7 千 100 萬股(基本)及 273 億 7 千 100 萬股(攤薄)。
- (3) 包括銅製程。
- (4) 從二零一一年第三季開始，產能利用率係依據生產過程中實際機器使用量計算。為了方便比較，以前季度之產能利用率已重新計算。以往，產能利用率係以實際生產晶圓量除以估計產能。

- 二零一二年第一季總銷售額由二零一一年第四季的 2 億 8 仟 9 佰 60 萬元上升至 3 億 3 仟 2 佰 70 萬元，錄得季度漲 14.9%，是由於晶圓付運量增加 19.1%所致。
- 二零一二年第一季的銷售成本與二零一一年第四季的 3 億 1 仟 1 佰萬元相比下降 5.8% 至 2 億 9 仟 2 佰 90 萬元，主要是由於二零一二年第一季採取的成本擰節舉措及於二零一一年第四季支付爾必達和解金增加成本 1 仟 1 佰 40 萬所致。
- 二零一二年第一季的毛利為 3 仟 9 佰 80 萬元，相對二零一一年第四季的毛損 2 仟 1 佰 30 萬元及二零一一年第一季的毛利 6 仟 8 佰 80 萬元。
- 二零一二年第一季的毛利率由二零一一年第四季的-7.4%上升至 12.0%，主要是由於更高的產能利用率及於二零一二年第一季採取的成本擰節舉措所致。
- 二零一二年第一季的經營開支由二零一一年第四季的 8 仟 5 佰 70 萬元上升 5.2%至 9 仟 零 10 萬元，主要是由於政府補助研發款項減少所致。

收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零一二年 第一度	二零一一年 第四度	二零一一年 第一度
電腦	3.2%	3.3%	3.3%
通訊	48.3%	44.1%	44.5%
消費	40.2%	42.5%	42.5%
其他	8.3%	10.1%	9.7%
以服務分類	二零一二年 第一度	二零一一年 第四度	二零一一年 第一度
晶圓 ⁽¹⁾	94.4%	92.2%	91.3%
光罩製造，晶圓測試及其它	5.6%	7.8%	8.7%
以客戶類別分類	二零一二年 第一度	二零一一年 第四度	二零一一年 第一度
無廠房半導體公司	91.4%	88.5%	80.4%
集成裝置製造商	5.0%	8.2%	13.5%
系統公司及其它	3.6%	3.3%	6.1%
以地區分類	二零一二年 第一度	二零一一年 第四度	二零一一年 第一度
北美洲	55.2%	55.9%	51.3%
中國 ⁽²⁾	32.5%	34.1%	35.6%
歐亞 ⁽³⁾	12.3%	10.0%	13.1%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一二年 第一度	二零一一年 第四度	二零一一年 第一度
40/45 納米	0.3%	0.3%	0.0%
55/65 納米	22.3%	21.0%	13.3%
90 納米	8.6%	9.2%	12.3%
0.13 微米	22.7%	22.3%	24.1%
0.15/0.18 微米	39.4%	37.2%	32.9%
0.25/0.35 微米	6.7%	10.0%	17.4%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港
- (3) 不包括中國

產能*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一二年 第一 度	二零一一年 第四 度
上海廠(8 吋)	79,210	90,000
北京廠(12 吋)	67,500	65,540
天津廠(8 吋)	37,839	37,750
每月晶圓代工生產總產能	184,549	193,290

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一二年 第一度	二零一一年 第四度	度比較	二零一一年 第一度	年度比較
銷售成本	292,867	310,959	-5.8%	301,782	-3.0%
折舊	106,317	106,150	0.2%	104,449	1.8%
其他製造成本	186,254	204,546	-8.9%	196,727	-5.3%
股權報酬	296	263	12.5%	606	-51.2%
毛利(損)	39,844	(21,331)	-	68,777	-42.1%
毛利率	12.0%	-7.4%	-	18.6%	-

- 二零一二年第一季的銷售成本與二零一一年第四季的3億1仟1佰萬元相比下降5.8%至2億9仟2佰90萬元，主要是由於二零一二年第一季採取的成本擲節舉措及於二零一一年第四季支付爾必達公司合解金增加成本1仟1佰40萬元所致。
- 二零一二年第一季的毛利為3仟9佰80萬元，相對二零一一年第四季的毛損2仟1佰30萬元及二零一一年第一季的毛利6仟8佰80萬元，其差異主要是由於與二零一一年第四季相比，晶圓付運增加19.1%及銷售成本下降5.8%所致。
- 二零一二年第一季的毛利率由二零一一年第四季的-7.4%上升至12.0%。

經營開支分析

以千美元計	二零一二年 第一度	二零一一年 第四度	度比較	二零一一年 第一度	年度比較
總經營開支	90,128	85,667	5.2%	76,623	17.6%
研究及開發	59,311	38,921	52.4%	49,573	19.6%
一般及行政	23,924	25,038	-4.4%	19,427	23.1%
銷售及市場推廣	6,892	9,283	-25.8%	7,738	-10.9%
其他，淨額	1	12,425	-	(115)	-

- 二零一二年第一季的研究及開發費用由二零一一年第四季的3仟8佰90萬元上升52.4%至5仟9佰30萬元，主要是由於相較於二零一一年第四季，二零一二年第一季政府補助研發款項減少所致。
- 二零一二年第一季的一般及行政費用為2仟3佰90萬元，與二零一一年第四季的2仟5佰萬元相比，其差額主要是由於人事相關費用及律師費用減少所致。
- 二零一二年第一季的銷售和市場推廣費用與二零一一年第四季的9佰30萬元相比，下降25.8%至6佰90萬元，主要是由於銷售活動下降所致。
- 二零一二年第一季的其他經營支出為1仟元，與二零一一年第四季的其他經營支出1仟2佰40萬元相比，其差異是由於在二零一一年第四季處份機器設備。

其他收入(支出)

以千美元計	二零一二年 第一 度	二零一一年 第四 度	度比較	二零一一年 第一 度	年度比較
其他收入(支出)，淨額	(4,069)	5,430	-	2,702	-

資本結構

以千美元計	二零一二年 第一 度	二零一一年 第四 度
現金及現金等價物	300,641	261,615
限制性現金	194,352	136,907
長期票據即期部分	29,582	29,374
長期票據長期部分	28,761	28,560
短期借款	467,069	607,427
長期借款的即期部份	191,619	191,355
長期借款	427,293	72,361
借款總計	1,085,981	871,143
股本 ⁽¹⁾	2,204,738	2,245,997
總債務股本比率	49.3%	38.8%

附注：

(1) 包括非控制權益部分

現金流量概要

以千美元計	二零一二年 第一 度	二零一一年 第四 度
來自於經營活動的現金淨額	35,808	

近期公佈

- 二零一一年年度業績公佈 (2012-03-29)
- 須予披露交易-中芯國 與 IBM 簽訂合作 議 (2012-03-29)
- SMIC@SEMICON China 2012 (2012-03-26)
- 董事名單與其角色和職能 (2012-03-26)
- 中芯 CEO 邱慈雲作 SEMICON 中國開幕演講 (2012-03-20)
- 中芯國 獲六億美元銀團貸款 (2012-03-16)
- 董事會通過刊發二零一一年度業績報告日期通 (2012-03-16)
- 中芯國 技術研發副總裁李序武博士 “高峰對話” 2012 中國半導體市場年會 (2012-03-15)
- 中芯國 、燦芯、浙 創辦合作實驗室 (2012-03-14)
- 中芯發佈 0.11 微米 UHD IP 庫解決方案 (2012-03-08)
- 中芯與燦芯 40LL ARM Cortex-A9 成功流片 (2012-02-27)
- 中芯國 截至二零一一年十二月三十一日止三個月業績公佈 (2012-02-08)
- 董事會會議日期通 (2012-01-18)

上述公佈詳情 參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/media_press.php 及 http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中芯國際集成電路製造有限公司
合併綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一二年 三月三十一日 (經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
銷售額，淨額	332,711	289,628
銷售成本	292,867	310,959
毛(損)利	39,844	(21,331)
經營費用：		
研究及開發	59,311	38,921
一般及行政	23,924	25,038
銷售和市場推廣	6,892	9,283
其他支出	1	12,425
經營費用總額，淨額	90,128	85,667
經營虧損	(50,284)	(106,998)
其他收入(支出)，淨額	(4,069)	5,430
除股權投資外的稅前營利(虧損)	(54,353)	(101,568)
所得稅利益(費用)	11,418	(65,040)
股權投資盈利	373	1,784
淨虧損	(42,562)	(164,824)
非控制權益持有人利息	(263)	(381)
中芯國 應佔虧損	(42,825)	(165,205)
淨虧損	(42,562)	(164,824)
其他綜合收入：外幣匯兌調整	44	4,399
綜合虧損	(42,518)	(160,425)
非控股權益應占綜合虧損	(263)	(381)
中芯國 應占綜合虧損	(42,781)	(160,806)
中芯國 應佔每股股份虧損，基本及攤薄	(0.00)	(0.01)
中芯國 應佔每股美國預托股份虧損，基本及攤薄	(0.08)	(0.30)
用作計算基本及攤薄每股普通股虧損額的股份	27,504,337,503	27,482,924,722

中芯國際集成電路製造有限公司
合併資產負債表

(以千美元為單位,每股資料除外)

	截至以下日期止	
	二零一二年 三月三十一日 (經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	300,641	261,615
限定用途的現金	194,352	136,907
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一二年三月三十一日\$45,500 仟元及二零一一年十二月三十一日\$42,821 仟元	196,749	165,234
存貨	211,353	207,309
預付款項及其它流動資產	118,023	93,722
流動資產合計	1,021,118	864,787
預付土地使用權	76,846	77,231
廠房及設備，淨額	2,493,732	2,516,578
購入無形資產，淨額	242,886	179,279
其他長期資產	103,619	90,054
資產合計	3,938,201	3,727,929
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	307,206	280,691
預提費用及其它流動負債	142,356	142,479
短期借款	467,069	607,427
長期票據的即期部份	29,582	29,374
長期借款的即期部份	191,619	191,355
流動負債合計	1,137,832	1,251,326
長期負債：		
長期票據	28,761	28,560
長期借款	427,293	72,361
其他長期負債	136,296	126,668
長期負債合計	592,350	227,589
負債合計	1,730,182	1,478,915
非控制權益	4,463	4,200
股東權益：		

普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股， 於二零一二年三月三十一日及二零一一年十 二月三十一日已發行及流通在外的股份分別 為 27,509,521,180 股及 27,487,676,065 股。	11,004	10,995
可轉換優先股，面值 0.0004 美元，法定股份 為 5,000,000,000 股， 於二零一二年三月三十一日及二零一一年十 二月三十一日已發行及流通在外的股份均為 445,545,911 股。	178	178
額外繳入股本	4,242,043	4,240,529
累計其他綜合虧損	3,889	3,845
累計虧損	(2,053,558)	(2,010,733)
股東權益合計	2,203,556	2,244,814
總負債，非控制權益及股東權益合計	3,938,201	3,727,929

中芯國際集成電路製造有限公司
合併現金流量表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一二年 三月三十一日 (經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
經營活動:		
淨損失	(42,562)	(164,824)
折舊及攤銷	142,503	145,216
股權投資收益	(373)	(1,783)
營運資本的改變及其它	(63,760)	106,050
經營活動所得現金淨額	35,808	84,659
投資活動:		
購入:		
廠房及設備	(116,366)	(89,120)
無形資產	(29,317)	(5,568)
短期投資	(4,167)	35,403
與投資活動有關受限制現金改變	(55,954)	88,428
其他	(1)	(3,740)
投資活動所得(耗)現金淨額	(205,805)	25,403
融資活動:		
短期借款的增長(減少)	(140,358)	36,961
長期借款的增長(減少)	355,197	(186,880)
償還長期票據支付的款項	-	(15,000)
其他	(5,861)	95
融資活動所得(耗)現金淨額	208,978	(164,824)
匯率變動的影響	44	687
現金及現金等價物增加(減少)淨額	39,025	(54,075)
現金及現金等價物—期間開始	261,615	315,690
現金及現金等價物—期間結束	300,641	261,615